

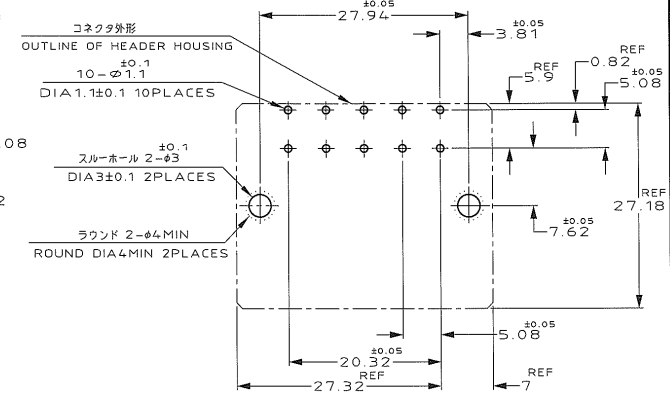
NUMBER 316080
 3RD ANGLE PROJECTION
 METRIC

DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

回路番号
CIRCUIT NO

AMPマーク
シリーズマーク
SERIES MARK



推奨基板取付け寸法
 PC 基板厚: 1.6±0.1
 (非累積公差)
 (コネクタ搭載面)

RECOMMEND PC BOARD HOLE PATTERN
 PC BOARD THICKNESS: 1.6±0.1
 (NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
 (CONNECTOR MOUNT SIDE)

- 注記
- 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性ポリエチレン樹脂 (94V-0), 色: 黒
 リテンションレグ: 銅合金
 - めっき: コンタクト: 全面Ni下地
 鍍層部: 0.38µm MIN金めっき
 - めっき: コンタクト: 全面Ni下地
 鍍層部: 0.76µm MIN金めっき
 - めっき: リテンションレグとコネクタ半田付部
 コンタクト半田付部の上にはスズめっき
 - めっき: リテンションレグとコネクタ半田付部: ニッケル下地の後にスズめっき

- NOTES
- MATERIAL: HOUSING: GLASS FILLED THERMO PLASTIC, POLYESTER (94V-0), COLOR: BLACK
 CONTACT: COPPER ALLOY
 RETENTION LEG: COPPER ALLOY
 - FINISH (CONTACT AREA): 0.38 mMIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
 - FINISH (CONTACT AREA): 0.76 mMIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
 - FINISH (CONTACT AREA): 2.0 PLATED OVER NICKEL
 - FINISH (RETENTION LEG): TIN LEAD PLATED (CONTACT TAIL)
 - FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL)

KEYING LOCATION	A ROW KEYING	B ROW KEYING	FINISH	製品番号	PART NO.
B ROW			△△	3-316080-5	
A ROW	X	Y	△△	3-316080-3	
			△△	3-316080-2	
B ROW			△△	2-316080-5	
A ROW	Y	Y	△△	2-316080-3	
			△△	2-316080-2	
B ROW			△△	1-316080-5	
A ROW	X	X	△△	1-316080-3	
			△△	1-316080-2	



WIRE RANGE		INSULATION DIA		NAME	
MATERIAL SEE NOTE		FINISH SEE NOTE		10 POS DOUBLE ROW HORIZONTAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC D-3200	
DR. K.IKEDA		DE. K.IKEDA		SCALE 2-1	
LTR REVISION RECORD		DR CHK DATE		REV. B3 SHEET 1 OF 1	

(CUSTOMER DRAWING) 顧客用図面